德國Schlötter
創立104年紀念

Schlötter

Galvanotechnik

超薄面銅雖是必要，但

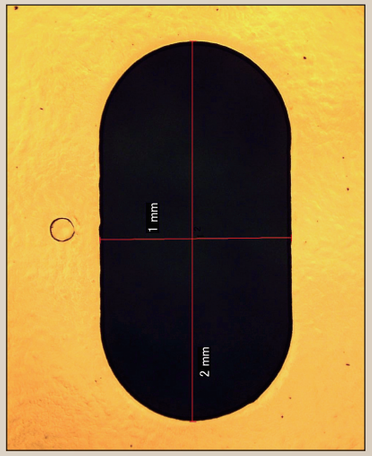
穩定的填孔良率才是王道！

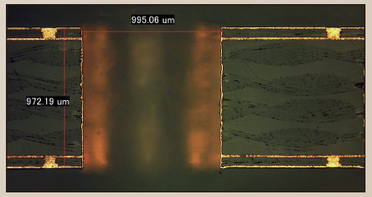
SLOTOCOUP SF-30

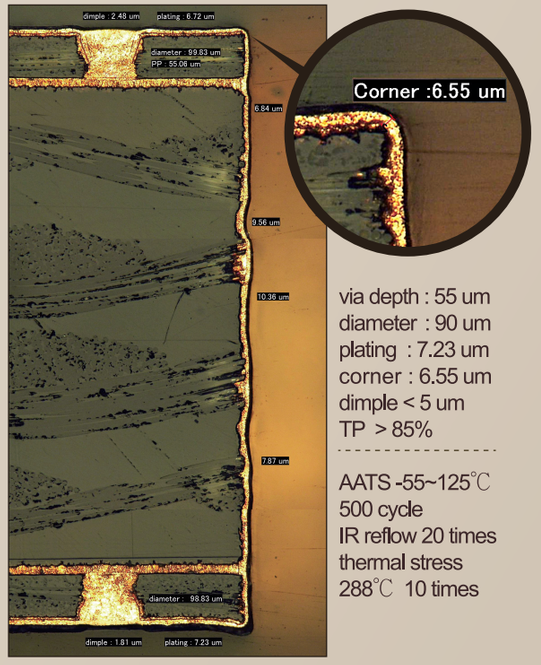
最穩定的超薄面銅填孔系統

滿足全球最火紅手機板之新設計規格！

SF-30 填孔系統之量產線其累積電量雖已達712 Ahr/L，但仍然可滿足目前最火紅手機 **”900,000孔板掃孔機0漏填 ”**之嚴苛要求，不僅如此，對於最新之 **”槽孔設計與孔角信賴性要求 ”**亦有優異之表現，而藥水之長期穩定性足可信賴！







via depth : 55 um
diameter : 90 um
plating : 7.23 um
corner : 6.55 um
dimple < 5 um
TP > 85%

AATS -55~125℃
500 cycle
IR reflow 20 times
thermal stress
288℃ 10 times

AGES 萬億 萬億股份有限公司

24889 新北市五股區五權六路六號
電話：02-2298-1841 (代表) 傳真：02-2298-0075
E- mail：triallian@agesgroup.com.tw